1. 晶圆耦合与测试
   1. 耦合
      1. 上下料
         1. 取出晶圆
         2. 放入晶圆
         3. 固定晶圆
            1. 抽真空提供吸力将晶圆吸合在chuck上
      2. 调整机台的姿态
         1. 调整角度
            1. 通过成像系统观察物体的角度
            2. 通过电机驱动的机械臂控制物体的姿态
         2. 调整位置
            1. 每个die的位置

对晶圆上的die进行编号

* + - * 1. 每个光口的位置

对die上的光口进行编号

* + - * 1. 移动到特定的die的特定的光口
      1. 防止碰撞
      2. 姿态保存和恢复
      3. 防意外掉电
    1. 找到最大光功率/电流的位置
  1. 测试
     1. 调整机台的姿态
     2. 进行测试
        1. 清针